

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



Egyérpáras Ethernet PCB-aljzatok

Az egyérpáras Ethernet egy olyan technológia, amely az adatok és a tápellátás továbbításához mindössze egyetlen pár vezetékot használ.

Eredményként az SPE lesz a kívánt hálózat terepszinten és azon túl is.

Az egyérpáras ETHERNET előnyei:

- Konzisztens: Az egyérpáras Ethernet segítségével uniformizálható az Ethernet-alapú kommunikáció az érzékelőktől a felhőig
- Időtálló: kulcsfontosságú technológia az Industry 4.0 és IoT területén
- Flexibilis: az akár 1000 m hatótávolság és az akár 1 Gbps átviteli sebesség lehetővé teszi az alkalmazások közötti használatot
- Innovatív: könnyebb, kisebb helyigény és egyszerűbb felszerelés

Általános rendelési adatok

Verzió	Beépített dugók, M8 PCB betét, IP67 házzal, SMD-forrasztott csatlakozás, 180°, Pólusszám: 2
Rendelési szám	2795110000
Típus	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
GTIN (EAN)	4064675119166
Qty.	100 Stück

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	14,5 mm	Mélység (coll)	0,571 inch
Magasság	22,1 mm	Magasság (coll)	0,87 inch
Szélesség	10,1 mm	Szélesség (coll)	0,398 inch
Nettó tömeg	5,14 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
-------------------	----------------

Electrical properties

Névleges feszültség	72 V	Névleges áram	4 A
Szigetelés erőssége	≥ 500 MΩ		

Standards

Csatlakozó, standard	IEC 63171-5
----------------------	-------------

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	LCP	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelés erőssége	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Ni/Au
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C

Csomagolás

VPE hosszúság	327 mm	VPE szélesség	327 mm
VPE magasság	52 mm		

Rendszerspecifikációk

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Felszerelés NYÁK-ra	SMD-forrasztott csatlakozás
Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás	Kategória	T1-B
Kimenő könyök	180°	Pólusszám	2
Teljesítménykategória	T1-B	Termékcsalád	Ipari Ethernet
Védelmi osztály	IP67 házzal		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

IE-PCB-SPM-P-180-SMD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

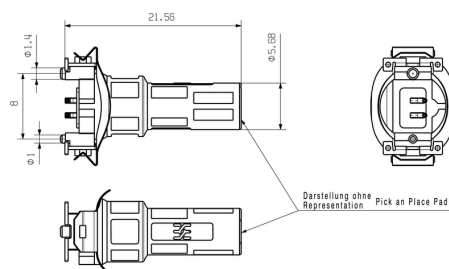
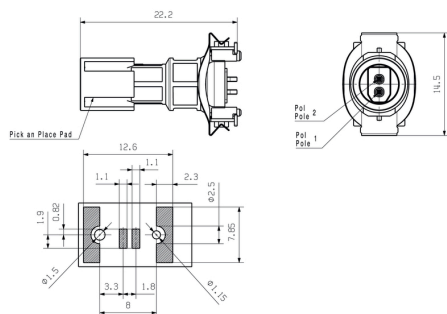
Engineering Data	CAD data – STEP
Technical Documentation	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.